

苏州国芯科技股份有限公司

2023年6月投资者关系活动记录表

证券简称：国芯科技

证券代码：688262

编号：2023-007

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	富国基金；银华基金；广发基金；华商基金；兴证全球基金；平安基金；中信证券；华泰证券；泰康资产；华泰资产；申港证券；信达澳亚基金；交银施罗德基金；广发证券；金信基金；国鸣资本；百年保险资管；西部利德基金；中金公司；招商证券；东吴证券；申万宏源证券；国信证券；安信证券；中银证券；长江养老保险；华鑫证券；光证资管；汇安基金；欣歌投资；财通资管；中邮证券；国盛证券；国海证券；浙商证券；瑞腾投资；博笃投资；伟晟投资；中信期货；彬元资本；财通证券；香港长盈基金；大箏资管；湖南万泰华瑞投资；国金证券；华美国际投资；括苍资产；睿亿投资；上海中道投资；上海宝弘资产；东方证券自营；寻常投资；光大宝德信资管；长江资管；国金证券自营；博亚投资；百年人寿；涌君投资；华林证券；石舍资产；凡石投资；上海重阳投资；留仁资产；南京证券；上海勉睿投资。
时间	2023年6月1日10:00；2023年6月1日15:00；2023年6月2日10:00； 2023年6月6日15:00；2023年6月7日15:00；2023年6月8日9:00； 2023年6月9日13:30；2023年6月14日13:00；2023年6月14日16:00； 2023年6月15日16:30；2023年6月16日13:30；2023年6月20日10:00； 2023年6月21日14:00；2023年6月21日15:00；2023年6月28日10:00； 2023年6月29日10:00；2023年6月30日10:00。
地点	线上交流、公司现场交流及券商策略会举办地上海交流
上市公司参加人员	董事长：郑荭先生；总经理：肖佐楠先生；董事会秘书：黄涛先生；证券事务代表：龚小刚先生。

姓名	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司汽车电子业务目前总体进展情况怎么样？</p> <p>答：目前，在车身和网关控制芯片、汽车动力总成控制芯片、汽车域控制芯片、新能源电池管理芯片、车联网安全芯片、汽车电子混合信号类芯片和汽车电子专用 SoC 芯片等 7 条产品线上，公司的中高端汽车电子芯片累计出货量已超过 500 万颗，公司汽车电子芯片产品在上述 7 条产品线已经实现系列化布局。同时，公司研发的安全气囊主控芯片已实现规模销售，点火芯片正在气囊控制器厂商进行实测，公司也正在开拓布局辅助驾驶处理芯片等新的产品线，努力成为中国汽车电子芯片产品的领先供应商，实现汽车电子芯片在产品系列化和性能指标两方面与国际一流厂商相媲美。</p> <p>今年一季度以来，虽然受到整车降价等带来的压力，但整体机遇大于挑战，汽车电子芯片国产替代的空间巨大，我们在汽车电子芯片领域面临着重大发展机遇。公司加快推出了安全气囊点火驱动专用芯片等汽车电子芯片新产品，与北京经纬恒润科技股份有限公司携手正式推出完整的 Classic Platform (CP) AUTOSAR 解决方案。公司将加大力度开拓整车厂和 Tier1 模组厂商的市场，努力打造国芯科技在汽车电子芯片领域的品牌形象，促进公司汽车电子芯片业务的持续发展。</p> <p>2、目前公司汽车电子业务的生态建设和市场开拓情况怎么样？</p> <p>答：目前，公司在苏州市相关部门的支持下领头建立了苏州市自主可控智能汽车电子芯片创新联合体，参与单位包括清华大学苏州汽车技术研究院、吉利、上汽和奇瑞等。公司与奇瑞汽车建立了联合实验室，促进车规级芯片技术、市场开发等方面的协同创新，致力于推动我国芯片生态与零部件生态、整车生态融合发展；由公司牵头并与苏州高新区等共同建设的苏州汽车电子芯片技术研究院，以国产化为抓手，面向新能源车等不同应用场景与各模组、软件、主机厂商合作、合资开发智能汽车电子产品等形式，实现苏州以及长三角区域汽车电子产业链的延伸，“抱团式”攻关装车应用。</p> <p>截至目前，基于公司汽车电子芯片进行应用产品开发的客户已超过 50 家，公司在汽车电子市场的影响力不断扩大，获得了国内汽车整机厂商和 Tier1 汽车电子模组厂商的好评和信赖，推进了汽车电子芯片产品的国产替</p>

代进程。2023 年一季度以来，公司持续围绕“头部客户”，树立“客户”第一的理念，服务好客户，特别是服务好比亚迪、吉利、奇瑞、上汽和长安等重点客户，并持续加快开拓新的客户，继续加强销售团队和技术服务支持团队建设，采取多元化的销售策略，力争进一步扩大批量供货客户的数量和规模，促进公司汽车电子芯片业务的进一步发展。

3、请介绍一下公司的安全气囊点火驱动专用芯片？

答：公司成功研发的 CCL1600B 芯片产品是基于公司高压混合信号平台研发的第一代安全气囊点火驱动专用芯片，该款新产品可实现对国外产品如博世 CG90X 系列以及 ST（意法半导体）的 L9679 系列相应产品的替代。CCL1600B 芯片按照汽车电子等级进行设计和生产，有望为解决我国汽车产业“缺芯”问题做出贡献。公司对上述芯片产品具有完全自主知识产权，并采用和国内头部车企协同创新的合作方式，产品开发阶段就受到国内汽车整机厂商的关注和开发支持，该款新产品的研发成功可实现对目前国内该领域占据主导地位的国外相应产品的替代，有利于打破国外垄断。

该款产品目前已在多家气囊控制器厂商进行产品开发和测试，并与公司已经装车超过百万颗规模的气囊控制 MCU 形成双芯片方案优势，市场前景良好。该款新气囊点火驱动芯片产品的研发成功也进一步丰富了公司的汽车电子产品线，有助于公司从 MCU 系列产品线拓宽到模数混合专用芯片领域，对公司未来汽车电子业务的市场拓展和业绩成长性预计都将产生积极影响。

4、公司在 AI 芯片上是否有相关规划或产品布局？

答：公司在 AI 芯片的布局包括：（1）在云 AI 芯片方面，公司围绕 AI 服务器应用，开发系列化芯片产品。目前已有芯片产品包括 Raid 控制芯片和超高速加解密处理芯片。未来公司将继续开展 AI 服务器芯片组的开发和应用；（2）在端 AI 芯片方面，公司已在生物特征识别领域推出了包括轻量级 AI（卷积协处理器）和安全处理的 SoC 芯片，实现指纹和人脸识别应用。未来公司将在现有基础上继续发展生物特征识别领域的高性能 AI 芯片；（3）公司正在开发 RISC-V CPU 内核系列，目前正在开展将 AI 引擎加入到 RISC-V CPU 内核中，形成具有 AI 引擎的 CPU 内核系列；（4）公司正在为客户 AI 芯片提供定制服务，目前已有 AI 芯片定制服务的在手订单；（5）公司将继续

和合作伙伴例如智绘微合作，开展 GPU 等技术的研发和应用。

5、请问公司设计的芯片是否自主可控，为解决芯片的“卡脖子”问题做出了哪些贡献？

答：公司重点以开源的“RISC-V 指令集”和“PowerPC 指令集”为基础，自研 C*Core 嵌入式 CPU 内核系列，并授权国内相关单位和公司使用，实现国产嵌入式 CPU 技术的自主可控。目前，公司在以下领域为“卡脖子”问题做出了贡献，具体内容如下：（1）公司对标 NXP MPC5634、MPC5554、MPC5674 研制了汽车发动机控制芯片 CCFC2003PT、CCFC2006PT 和 CCFC2007PT 等芯片系列；对标 ST S32K、NXP MPC5744 研制了车身/网关控制、域控制器芯片 CCFC2012BC、CCFC2016BC 等芯片系列；对标 NXP MPC5775E、MPC5777M 研制了新能源电池管理 BMS 控制芯片及域控制芯片 CCFC3008PT、CCFC3007PT 等芯片系列；对标 ST Stellar-E 正在研制新能源汽车 OBC DC-DC 芯片 CCFC3010PT；对标 ADSP2156X 正在研制汽车主动降噪 SoC 芯片 CCD5001 芯片；对标 Bosch 安全气囊点火芯片 CG904 研制了 CCL1600B 芯片。上述多款芯片产品已通过汽车电子标准级测试和相应行业测试，实现量产；（2）公司对标 LSI 9361 系列研制了第一代 RAID 芯片 CCRD3316；另外公司对标 LSI 95 系列正在研制第二代 RAID 芯片 CCRD4516；（3）公司对标 NXP 的边缘计算和通信处理芯片 T1022 研制了 CCP1080T 等芯片系列。

6、公司在新能源电池管理芯片上的布局怎么样？

答：2022 年 8 月 31 日，公司公告披露了公司成功研发的 CCFC2007PT 芯片产品可以应用于新能源电池管理(BMS)控制芯片。CCFC2007PT 芯片已在国内头部汽车动力电池厂商开始环境试验。公司正在开展新一代高性能新能源电池管理控制芯片 CCFC3008PT 的研发，进展顺利。公司立项开发面向动力电池 DC-DC 和 OBC 应用的 CCFC3010PT 芯片，该款芯片内嵌公司自有的 RISC-V 架构 CPU CRV4E，为公司首款基于 RISC-V 指令架构的车规 MCU 芯片产品。

7、请问公司端安全芯片业务进展情况怎么样？

答：公司持续聚焦生物特征识别、金融安全和物联网安全等领域，公司的终端安全主控芯片产品在金融 POS 机、智能门锁、指纹识别等领域在国内已占有较高的市场份额。端安全芯片系列包含身份认证、数字签名、数据加解密及

	<p>通信接口等功能，产品通过相关部门安全认证。在数字人民币领域，端安全芯片可以用于基于数字人民币的数字钱包和交易机具等，主要客户涵盖数字钱包和交易机具厂商，公司主要提供芯片和基于芯片的模组，并与客户联动开展新一代芯片产品开发。在视频监控安全领域，公司端安全芯片也已实现规模化销售，所占市场份额在国内处于领先地位。此外，公司端安全芯片作为可信计算芯片也已应用于电子政务笔记本、信创 PC 和打印机等领域。</p> <p>基于自主可控 RISC-V 指令架构 CRV0 CPU 内核，公司研发的 CCM3310S-L、CCM3309S 端安全芯片已规模化应用于智能穿戴 eSIM、版权保护、ETC OBE-SAM、燃气表安全 SE 和直播星 SE 等物联网应用领域。上述 RISC-V 安全芯片内置高安全防护机制，支持 DES、AES、RSA、ECC、SHA 等国际算法，SM2、SM3、SM4 等国密算法，安全等级达到国家密码管理局商用密码检测中心《安全芯片密码检测准则》第二级要求。芯片具备高安全性、超低功耗和小尺寸等特点。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 6 月